

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

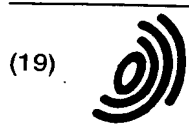
Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt

Europ an Patent Office

Office europ n des brevets



(11) **EP 1 046 576 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
25.10.2000 Patentblatt 2000/43

(51) Int. Cl.⁷: **B64C 1/18**, F24D 13/02,
B64C 1/40

(21) Anmeldenummer: 00106295.9

(22) Anmeldetag: 23.03.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Meisiek, Jürgen**
25587 Münsterdorf (DE)

(74) Vertreter:
Hansmann, Dierk, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Hansmann-Klickow-Hansmann
Jessenstrasse 4
22767 Hamburg (DE)

(30) Priorität: 24.04.1999 DE 19918736

(71) Anmelder:
DaimlerChrysler Aerospace Airbus Gesellschaft
mit beschränkter Haftung
21129 Hamburg (DE)

(54) **Plattenbauteil, insbesondere für eine Fussbodenplatte in einem Flugzeug**

(57) Bei einem Plattenbauteil (1), insbesondere für eine Fußbodenplatte in einem Flugzeug, wobei das Bauteil im wesentlichen aus mehreren Schichten aufgebaut ist und zumindest einen Wabenkern (2) und mindestens eine untere und mindestens eine obere Deckschicht (3,5) aufweist, wobei die Deckschichten aus GFK und/oder CFK-Lagen bestehen, besteht die Erfindung darin, daß ein Folienheizer (8) zumindest bereichsweise in das Plattenbauteil (1) eingebracht ist und eine wärmeleitende obere Deckplatte (11) vorgesehen ist.

Dabei ist insbesondere von Vorteil, daß eine erhebliche Gewichtsreduzierung gegenüber den bisherigen Lösungen erreicht wird, was insbesondere für den Einsatz im Flugzeugbau ein wesentliches Erfordernis darstellt. Für die Beheizung von kalten Fußbodenbereichen in der Flugzeugpassagierkabine wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung ohne störende Warmluftströme erreicht.

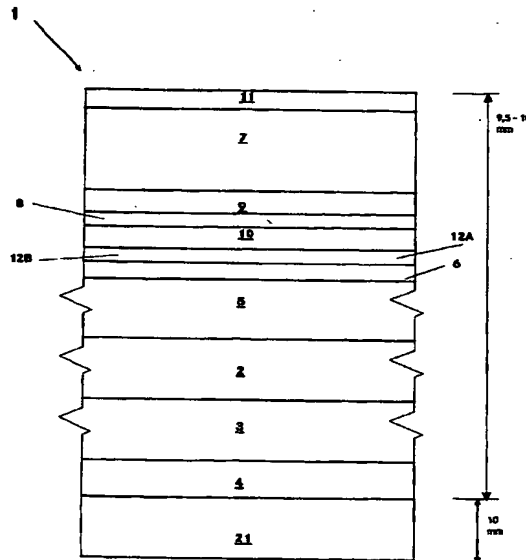


Fig. 1

EP 1 046 576 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Plattenbauteil, insbesondere für eine Fußbodenplatte in einem Flugzeug, wobei das Bauteil im wesentlichen aus mehreren Schichten aufgebaut ist und zumindest einen Wabenkern und mindestens eine untere und mindestens eine obere Deckschicht aufweist, wobei die Deckschichten aus GFK und/oder CFK-Lagen bestehen.

[0002] Solche Plattenbauteile werden als Sandwichstrukturen in Honigwabenbauweise, auch als Honeycomb-Sandwich-Strukturen bezeichnet, und bestehen aus einem Wabenkern sowie wenigstens je einer unteren und einer oberen Decklage. Die Decklagen sind üblicherweise kohlefaserverstärktes- und/oder glasfaserverstärktes Verbundmaterial (CFK, GFK), die in einem Autoklaven unter Zuführung von Wärme und Druck mit dem Wabenkern verbunden werden. Entsprechend dem Einsatzzweck und der notwendigen Festigkeit sind die Abmessungen des Wabenkerns sowie der Decklagen auszuwählen. Ein Beispiel einer Honeycomb-Sandwich-Struktur ist der Zeitschrift „Flight International“, 17. April 1982, Seiten 988 und 989 zu entnehmen.

[0003] Zum Einsatz kommen solche Plattenbauteile insbesondere im Flugzeugbau, da hier das geringe Gewicht verbunden mit einer hohen Festigkeit von besonderer Bedeutung ist. So werden Fußbodenplatten im Flugzeug aus solchen Plattenbauteilen hergestellt. Zur Abdeckung der Fußbodenplatten in der Passagierkabine sind Kunststoffbodenbeläge „NTF“ (Non Textile Floor) oder Textilteppiche vorgesehen. Es besteht innerhalb der Passagierkabine im Türbereich des Flugzeuges das Problem, daß im Fußbodenbereich eine Beheizung vorgesehen werden muß. Grund der Beheizung sind die relativ niedrigen Temperaturen (bis ca. -15°C) im Türbereich, die sich bei Flugzeugaußenhauttemperaturen bis -55°C in hohen Flughöhen nach ca. 5h Flugdauer einstellen. Ein Isolierschutz durch die Fußbodenbeläge als passive Maßnahme ist nicht ausreichend und es muß Wärmeenergie zugeführt werden. Dafür sind einerseits Luftheizungssysteme bekannt, die in diesen Türbereich warme Luft zuführen. Nachteilig ist bei diesen Warmluftsystemen der Wirkungsgrad, d.h. eine höhere elektrische Anschlußleistung, wechselnder Luftstrom der Klimaanlage, höheres Gewicht, keine homogene Flächentemperatur der Platte sowie die Beeinträchtigung der Passagiere bzw. des Flugpersonals durch die Luftzirkulation. Die Verschmutzung der Luftauslässe und auch die Gefahr des Dichtstellens der Luftauslässe durch Gepäck sind weitere Nachteile. Als Alternativlösung wurden separat beheizbare Metallfußbodenplatten auf herkömmliche Fußbodenplatten aufgeschraubt. Auch eine solche Lösung ist mit einem hohen Gewicht sowie einem hohen Energieverbrauch verbunden.

[0004] Aus DE 39 22 465 A1 ist eine Plattenbauteil bekannt, in die eine elektrische Heizvorrichtung eingebettet ist.

Das Plattenbauteil ist vorzugsweise als Sperrholzplatte ausgebildet und für Anwendungsfälle im Hausbau bzw. Haushaltsbereich vorgesehen. Die Heizvorrichtung ist aus einer Mehrzahl von bandförmigen Elektroden und einer Kunststoff-Strahlungskörperlage gebildet, wobei für die Strahlungskörperlage Kohlenstoffpartikelheizer Anwendung finden. Eine derartige Heizvorrichtung ist nicht für die Anwendung im Flugzeugbau geeignet, da solche Kohlenstoff-Gemische aufgrund ihres Brandverhaltens für die Anwendung im Passagierbereich nicht in Frage kommen bzw. nur durch aufwendige Sicherheitsmaßnahmen einsetzbar wären, die zusätzliches Gewicht und Kosten bedeuten.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein gattungsgemäßes Plattenbauteil zu schaffen, das im Bereich von Flugzeugtüren innerhalb einer Passagierkabine oder anderen kalten Räumen im Fußbodenbereich eingesetzt werden kann, um homogene Fußbodenoberflächentemperaturen, vorzugsweise im Bereich von +20°C bis +35°C, zu erreichen und insbesondere eine Gewichtsreduzierung zu den bisherigen Lösungen ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einem gattungsgemäßen Plattenbauteil mit den im Patentanspruch 1 genannten Maßnahmen gelöst.

[0007] Dabei ist insbesondere von Vorteil, daß eine erhebliche Gewichtsreduzierung gegenüber den bisherigen Lösungen erreicht wird, was insbesondere für den Einsatz im Flugzeugbau ein wesentliches Erfordernis darstellt. Für die Beheizung von kalten Fußbodenbereichen in der Flugzeugpassagierkabine wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung ohne störende Warmluftströme erreicht.

[0008] Weiterbildungen und vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen 2 bis 10 angegeben.

[0009] Dabei ist mit der Maßnahme gemäß Anspruch 2 insbesondere erreicht, daß der Folienheizer mit einfachen Mitteln in den Plattenbauteilverbund eingebracht werden kann.

[0010] Im Anspruch 3 ist eine vorteilhafte Ausbildung des Folienheizers angegeben.

[0011] Die Ausbildung des Anspruchs 4 zeigt eine Deckplatte, die einerseits ein Schutz gegen Beschädigungen und mechanischen Beanspruchungen und andererseits eine homogene Wärmeverteilung an der Oberfläche des Plattenbauteils ermöglicht.

[0012] Die Maßnahmen gemäß Anspruch 5 und 6 gewährleisten eine Temperaturregelung des Plattenbauteils entsprechend des Wärmebedarfes, wobei im Störfall eine Hilfsregelung und als Sicherheitsmaßnahme ein Schutz gegen Überhitzung vorgesehen ist.

[0013] Mit der Ausbildung gemäß des Anspruchs 7 ist eine mögliche Integration der elektrischen Bauteile und/oder der Elektronikbauteile in das Plattenbauteil aufgezeigt.

[0014] Die Maßnahme gemäß Anspruch 8 zeigt eine Möglichkeit des Schutzes der Bauteilplatte gegen

eindringende Feuchtigkeit.

[0015] Die Ausgestaltungen gemäß der Ansprüche 9 und 10 sehen vor, daß ein sicheres Abschalten der Stromzuführung erfolgt, wenn beispielsweise das Plattenbauteil beschädigt wird.

[0016] Mit der Ausbildung gemäß des Anspruches 11 können Wärmeverluste an der Fußbodenplatte reduziert werden, was den notwendigen Energiebedarf für die Beheizung vermindert.

[0017] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt, das nachstehend anhand der Figuren 1 bis 6 näher beschrieben wird. In den Figuren sind gleiche Bauteile mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0018] Es zeigt

- Fig. 1 den Aufbau eines Plattenbauteils,
 Fig. 2 das erfindungsgemäße Plattenbauteil im Bereich eines elektrischen Anschlußelementes in der Draufsicht,
 Fig. 3 das elektrische Anschlußelement gemäß Fig. 2 in einer Seitenansicht und
 Fig. 4 bis 6 die Aussparungen im Plattenbauteil für Sensor- und Schaltelemente.

[0019] In Fig. 1 ist der Aufbau eines Plattenbauteils 1 ersichtlich. Ein solches Plattenbauteil 1, auch als Honeycomb-Sandwich-Struktur bezeichnet, besteht aus einem Wabenkern 2 und mehreren Deckschichten 3, 4, 5, 6 und 7. Die Deckschichten 3, 4, 5, 6 und 7 sind entsprechend dem Einsatzzweck und der notwendigen Festigkeit in Dicke und Ausführung auszuwählen. Für den Einsatz als Fußbodenplatte in einem Flugzeug sind die Deckschichten 3 und 4 als untere Deckschichten vorgesehen, wobei die dem Wabenkern 2 nächstliegende Lage 3 als eine kohlefaserverstärkte Prepreg-Materialschicht (carbon fiber prepreg) und die darunterliegende Lage 4 als eine glasfaserverstärkte Prepreg-Materialschicht (gfk-pf-prepreg) 4 ausgebildet ist. Oberhalb des Wabenkerns 2 ist als obere Deckschicht 5 eine kohlefaserverstärkte Prepreg-Materialschicht (CFK-Platte) sowie Decklagen 6 und 7 aus Prepreglagen, wie Fiberglass-epoxy-prepreg vorgesehen. Mit Prepreg wird mit aushärtbarem Kunstharz vorimprägniertes Fasermaterial bezeichnet. Ein solches Plattenbauteil 1 für den Einsatz als Fußbodenplatte hat aufgrund ihrer Leichtigkeit und ihrer Festigkeit einen wesentlichen Vorteil für den Einsatz in einem Flugzeug. In bestimmten Bereichen des Flugzeugfußbodens, insbesondere im Türbereich des Flugzeuges, ist es notwendig, Beheizungseinrichtungen vorzusehen, da es vor allem bei Langstreckenflügen in großen Höhen bei Flugzeugaußenhauttemperaturen bis zu -55°C im Fußbodenbereich zu Minusgraden bis -15°C kommen kann. Dafür ist erfindungsgemäß zwischen den oberen Deckschichten 6 und 7, ein Folienheizer 8 eingebracht. Der Folienheizer 8 ist vorzugsweise aus Kapton/Cupron-Folien-Heiz-

elementen gebildet. Kapton ist das Trägermaterial für solche Heizfolien, Cupron (Legierung) ist ein Heizmaterial. Als alternatives Heizmaterial kann Manganin verwendet werden. Die Heizelemente für den Folienheizer 8 weisen in einer bevorzugten Ausführung einen linearen Temperaturkoeffizienten auf und können zum Erreichen der notwendigen homogenen Temperaturverteilung lokal individuelle Leistungen aufbringen. Zwischen den Fiberglass epoxy-prepreg-Lagen 6 und 7 werden mittels Epoxidharzschichten (epoxy film adhesive) 9 und 10 die Folienheizelemente 8 angeordnet und verklebt.

Die Bauteilplatte 1 enthält als obere Abdeckung eine wärmeleitende Deckplatte 11 als Schutz gegenüber mechanischer Beanspruchung und zur Wärmeverteilung. Vorgesehen ist dafür eine relativ dünne, ca. 0,5 mm starke oberflächenvergütete Metallplatte, vorzugsweise aus dem Werkstoff Aluminium. Die Aluminiumplatte 11 ermöglicht einen schnellen Wärmetransport und eine homogene Wärmeverteilung. Die Metalldeckplatte 11 wird mit den anderen Schichten als Composite verklebt.

Zur Temperaturregelung an dem Plattenbauteil 1 ist eine elektronische Temperaturregeleinheit vorgesehen, die mittels eines PTC-Sensors 12A die Temperaturverteilung im Plattenbauteil 1 ermittelt und die Wärmeleistung des Folienheizers 8 für eine homogene Temperaturverteilung regelt. Bei Ausfall dieser Regelung ist zur Verhinderung einer Überhitzung der Platte 1 ein Übertemperaturschalter 12B mit zwei Abschaltstufen vorgesehen. Bei Erreichen der obersten Stufe, beispielsweise bei 80°C, wird die Plattenbeheizung solange abgeschaltet wie Spannung anliegt. Somit ist eine Überhitzung der Platte 1 ausgeschlossen und der entsprechende Folienheizer 8 ist ausgeschaltet. Die untere Stufe des Übertemperaturschalters regelt den Folienheizer 8 in einem bestimmten Temperaturniveau. Vorzugsweise kann ein Bimetall-Schalter verwendet werden, der z. B. in einem Temperaturbereich von 30°C bis 60°C (mit einer gewissen Toleranz von ca. +/- 5°C) den Heizkreis regelt. Die obere Stufe des Übertemperaturschalters 12B ist somit als Sicherheitsabschaltung bei einer Überhitzung vorgesehen und kommt erst zum Einsatz, wenn auch die untere Stufe des Übertemperaturschalters 12B ausgefallen ist.

Der PTC-Sensor 12A sowie der Übertemperaturschalter 12B sind ebenfalls in die Bauteilplatte 1 integriert. Vorzugsweise sind Folienelemente zu verwenden, die zwischen der Epoxidharzschicht (epoxy film adhesive) 10 und der Fiberglass-epoxy-prepreg-Lage 6 eingebracht wurden.

[0020] Die CFK-Platten 3 und 5 und die Metalldeckplatte 11 werden elektrisch auf Massepotential gelegt, um ein sicheres Abschalten für den Kurzschlußfall, beispielsweise bei Beschädigung der Platte, zu gewährleisten. Zusätzlich sollte in der Temperaturregeleinheit eine elektronische Überwachung des Heizstromes vorgesehen sein, damit im Kurzschlußfall der

Stromkreis unterbrochen wird.

[0021] Die Bauteilplatte 1 wird als Verbund der verschiedenen Lagen in einem Autoklaven bei entsprechender Temperatur und vorzugsweise unter Vakuum hergestellt. Mit der Herstellung unter Vakuum vermeidet man Lufteinschlüsse in der Bauteilplatte 1, die nachteilig für die Anwendung derselben bei wechselnden Druckverhältnissen während des Einsatzes des Flugzeuges ist. Die Festigkeit der Bauteilplatte 1, die für die Anwendung als Flugzeugfußbodenplatte notwendig ist, wird durch den Aufbau mit kohlefaserverstärkten und glasfaserverstärkten Decklagen 3, 4, 5, 6 und 7, dem Wabenkern 2 und der Deckplatte 11 gewährleistet. Eine solche Bauteilplatte 1 hat ungefähr eine Stärke von 9,5 mm. Unterhalb dieses Verbundes kann zur Reduzierung von Wärmeverlusten eine ca. 10 mm starke Isolierschicht 21, beispielsweise aus Kunststoffschäum, angeordnet sein.

Für andere Einsatzzwecke mit anderen Festigkeitsanforderungen kann die Verbundbauplatte 1 im Aufbau und den Schichtdicken variiert werden.

[0022] In Fig. 2 ist eine Draufsicht auf einen Ausschnitt eines erfindungsgemäßen Plattenbauteils 1 im Bereich eines Kabelanschlusses gezeigt. Ein Kabelbündel 13 ist über Einzelleitungen (beispielsweise 14) mit der Heizfolie 8 verbunden. Eine Verbindung zu den Meß- und Schalterelementen ist ebenfalls vorgesehen. Es kann auch eine gedruckte Schaltung verwendet werden, die an Leitungen des Kabelbündels 13 angeschlossen wird. Notwendig ist auch eine Verbindung zur Gehäusemasse (CASE GND) 14A, d. h. eine Verbindung zur Aluplatte 11. Das Kabelbündel 13 ist mittels eines Kabelbinders 13A am Halter 13B der Bauteilplatte 1 befestigt.

[0023] In Fig. 3 ist die Seitenansicht auf den Bereich des Plattenbauteils 1 mit dem Kabelbündel 13 ersichtlich. Für den Kabelanschluß ist in der Platte 1 ein entsprechender Freiraum 15 vorgesehen, um das Herstellen der elektrischen Verbindungen zu ermöglichen. Ein Schrumpfschlauch 16 wird als Schutzmaßnahme über das Kabelbündel 13 gezogen. Nach Fertigstellung der Verbindungen wird der Freiraum 15 sowie ein Übergangsbereich 17 zwischen Außenfläche der Platte 1 und Kabelbündel 13 mit einem wasserdichten Verguß versehen. Vorteilhaft ist hier die Anwendung von Epoxidharz. Damit ist eine ausreichende Feuchtigkeitsdichtigkeit und Skydrofestigkeit erreicht.

[0024] In den Fig. 4 bis 6 ist die Integration des PTC-Sensors 12A sowie der Übertemperaturschalter 12B in die Bauteilplatte 1 ersichtlich. In der Bauteilplatte 1 sind entsprechende Aussparungen 18 und 19 vorgesehen, da diese Elektronikbauteile noch nicht bei der Plattenherstellung in Verbundbauweise unter Wärme und Druck eingebracht werden können. Fig. 4 zeigt die Fußbodenaussparung 18 für die erste Stufe des Übertemperaturschalters 12B und Fig. 5 die Aussparung 19 für die zweite Stufe des Übertemperaturschalters 12B. In beiden Fällen werden die Aussparungen 18 bzw. 19

von der Deckplatte 11 überdeckt. In Fig. 6 ist eine Aussparung 20 in der Platte 1 gezeigt. Diese Aussparung 20 ist für den PTC-Sensor 12A vorgesehen. Als obere Abdeckung ist die Deckplatte 11 angeordnet. Die Elektronikbauteile 12A und 12B sind vorzugsweise jeweils an der Deckplatte 11 verklebt und mit der Heizfolie 8 verbunden. In allen Fällen können nach Herstellung einer funktionsfähigen Verbindung der elektrischen Bauteile die Aussparungen mit vorzugsweise Epoxidharz vergossen werden.

Patentansprüche

1. Plattenbauteil, insbesondere für eine Fußbodenplatte in einem Flugzeug, wobei das Bauteil im wesentlichen aus mehreren Schichten aufgebaut ist und zumindest einen Wabenkern und mindestens eine untere und mindestens eine obere Deckschicht aufweist, wobei die Deckschichten aus GFK und/oder CFK-Lagen bestehen, **dadurch gekennzeichnet, daß** ein Folienheizer (8) zumindest bereichsweise in das Plattenbauteil (1) eingebracht ist und eine wärmeleitende obere Deckplatte (11) vorgesehen ist.
2. Plattenbauteil nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Folienheizer (8) zwischen zwei oberen Deckschichten (6, 7) aus GFK-Lagen angeordnet ist und eine weitere obere Deckschicht (5) zwischen Wabenkern (6) und GFK-Lagen (6, 7) eine CFK-Lage bildet.
3. Plattenbauteil nach einem der Ansprüche 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Folienheizer (8) aus Kapton/Cupron (bzw. Manganin)-Folien-Heizelementen gebildet ist.
4. Plattenbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet, daß** als wärmeleitende obere Deckplatte (11) eine Aluminiumplatte, die als Deckschicht mit den anderen Schichten verklebt wird, vorgesehen ist.
5. Plattenbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, daß** eine Temperaturregeleinheit zur Regelung des Folienheizers (8) vorgesehen ist, wobei ein PTC-Sensor (12A) sowie mindestens ein Übertemperaturschalter (12B) in das Plattenbauteil (1) integriert ist.
6. Plattenbauteil nach Anspruch 5, **dadurch gekennzeichnet, daß** der Übertemperaturschalter (12B) zweistufig ausgebildet ist, wobei eine erste Abschaltstufe innerhalb eines vorbestimmten Temperaturbereiches Mittel zum Regeln aufweist und eine zweite

Abschaltstufe bei Erreichen einer Überhitzungstemperatur abschaltet.

7. Plattenbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß 5
Aussparungen (15, 18, 19, 20) im Plattenbauteil (1)
zur Aufnahme zumindest der Anschlußleitungen
(14) des Kabelbündels (13), des PTC-Sensors
(12A) sowie des Übertemperaturschalters (12B)
vorgesehen sind. 10
8. Plattenbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß
die vorhandenen Aussparungen (15, 18, 19, 20) am
Plattenbauteil (1) und/oder Kabelanschlußstellen 15
(17) mit einem wasserdichten Verguß, vorzugs-
weise Epoxidharz, versehen sind.
9. Plattenbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß 20
die CFK-Lagen (3, 5) und/oder die Metaldeckplatte
(11) elektrisch auf Massepotential gelegt werden.
10. Plattenbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß 25
die Temperaturregeleinheit weiterhin ein Mittel zur
Überwachung des Heizstromes, die im Kurzschluß-
fall abschalten, aufweist.
11. Plattenbauteil nach einem der Ansprüche 1 bis 10, 30
dadurch gekennzeichnet, daß
eine Isolierschicht (21) als weitere Lage im Platten-
bauteilverbund, vorzugsweise unterhalb der Sand-
wichstruktur vorgesehen ist.

35

40

45

50

55

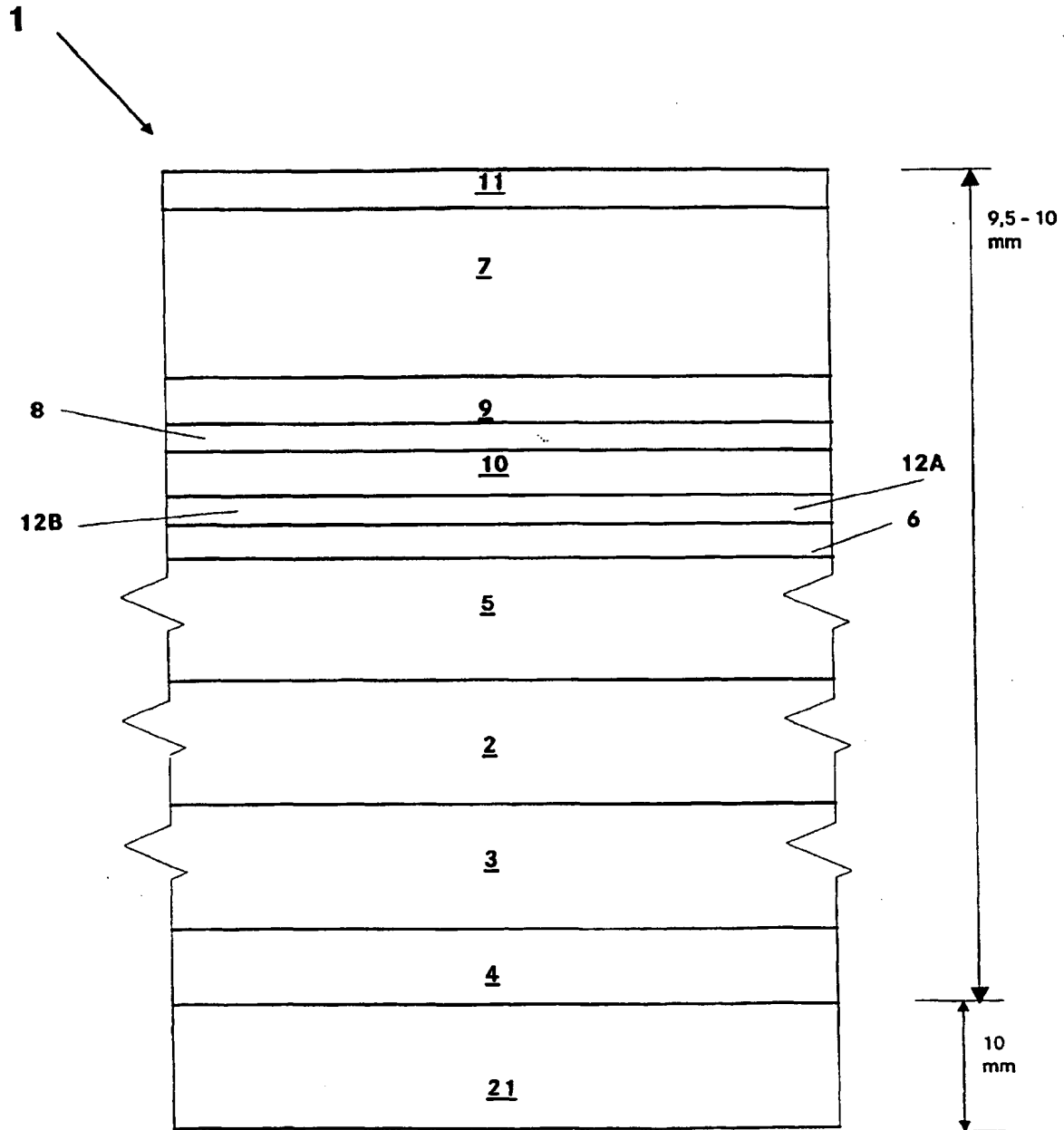


Fig. 1

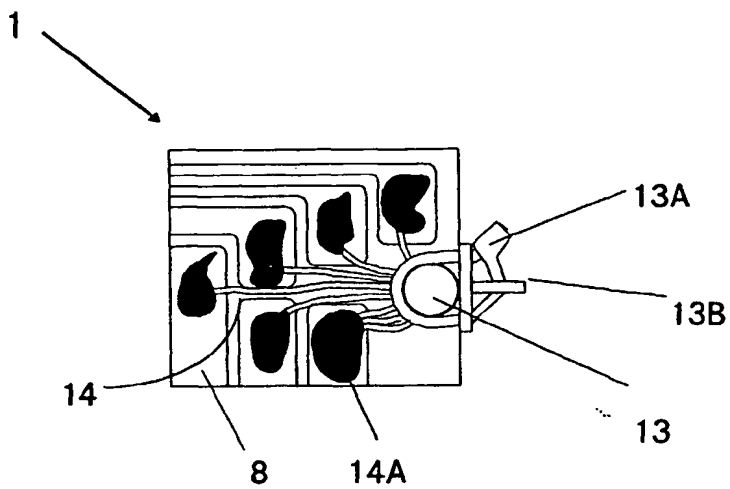


Fig. 2

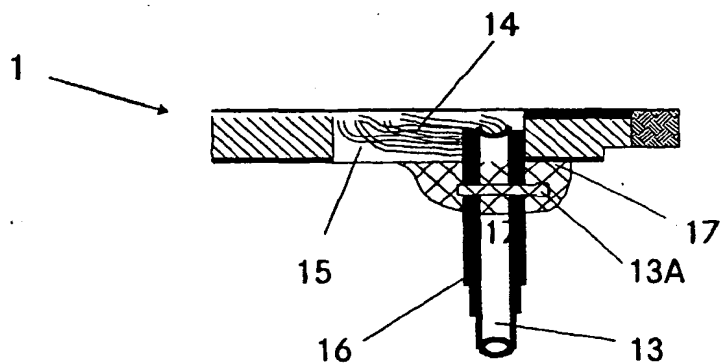


Fig. 3

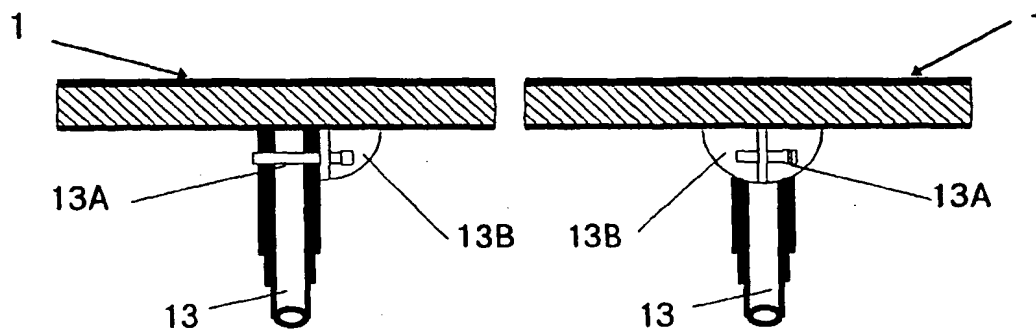


Fig. 4

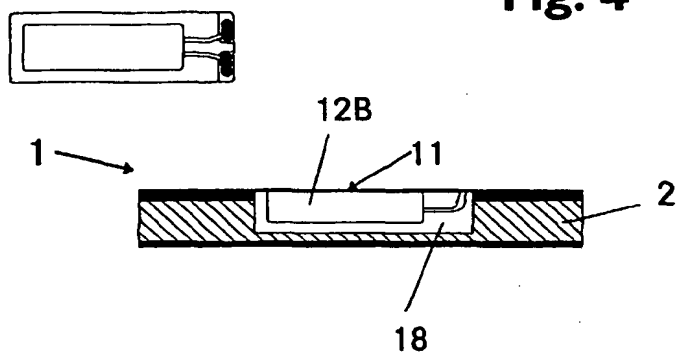


Fig. 5

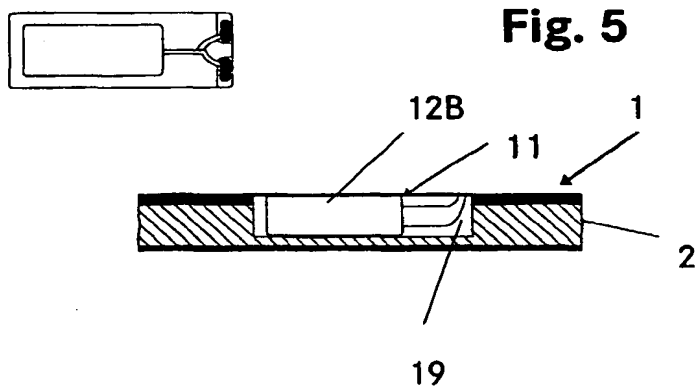
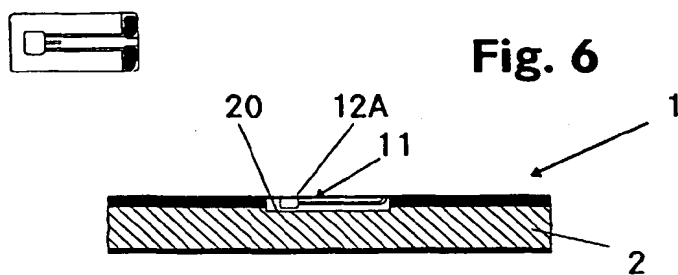
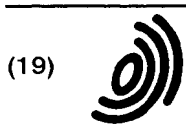


Fig. 6





Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 046 576 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
02.11.2000 Patentblatt 2000/44

(51) Int. Cl.⁷: **B64C 1/18**, F24D 13/02,
B64C 1/40

(43) Veröffentlichungstag A2:
25.10.2000 Patentblatt 2000/43

(21) Anmeldenummer: 00106295.9

(22) Anmeldetag: 23.03.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Meisiek, Jürgen**
25587 Münsterdorf (DE)

(74) Vertreter:
Hansmann, Dierk, Dipl.-Ing.
Patentanwälte
Hansmann-Klickow-Hansmann
Jessenstrasse 4
22767 Hamburg (DE)

(30) Priorität: 24.04.1999 DE 19918736

(71) Anmelder: **EADS Airbus GmbH**
21129 Hamburg (DE)

(54) **Plattenbauteil, insbesondere für eine Fussbodenplatte in einem Flugzeug**

(57) Bei einem Plattenbauteil (1), insbesondere für eine Fußbodenplatte in einem Flugzeug, wobei das Bauteil im wesentlichen aus mehreren Schichten aufgebaut ist und zumindest einen Wabenkern (2) und mindestens eine untere und mindestens eine obere Deckschicht (3,5) aufweist, wobei die Deckschichten aus GFK und/oder CFK-Lagen bestehen, besteht die Erfindung darin, daß ein Folienheizer (8) zumindest bereichsweise in das Plattenbauteil (1) eingebracht ist und eine wärmeleitende obere Deckplatte (11) vorgesehen ist.

Dabei ist insbesondere von Vorteil, daß eine erhebliche Gewichtsreduzierung gegenüber den bisherigen Lösungen erreicht wird, was insbesondere für den Einsatz im Flugzeugbau ein wesentliches Erfordernis darstellt. Für die Beheizung von kalten Fußbodenbereichen in der Flugzeugpassagierkabine wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung ohne störende Warmluftströme erreicht.

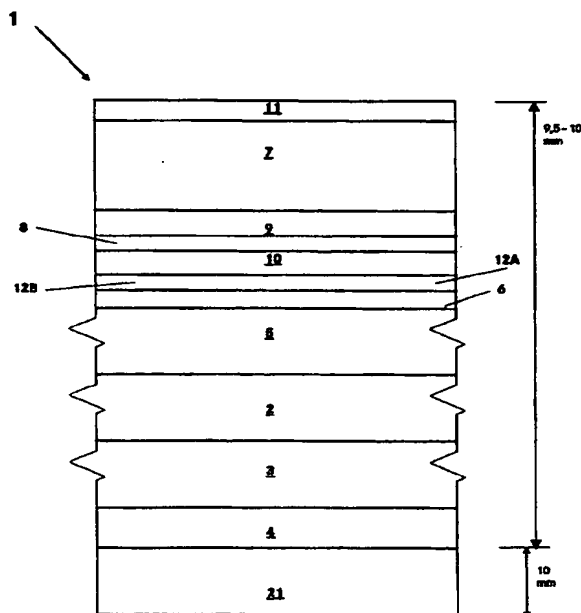


Fig. 1

EP 1 046 576 A3



Eur päisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 10 6295

| EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE | | | |
|--|--|-----------------------------|---|
| Kategorie | Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile | Betrifft Anspruch | KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7) |
| Y | PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 05, 30. Juni 1995 (1995-06-30) & JP 07 032518 A (DAIRIN SHOJI:KK), 3. Februar 1995 (1995-02-03) | 1,3,4,9, 11 | B64C1/18 F24D13/02 B64C1/40 |
| A | * Zusammenfassung * | 2,7 | |
| Y | US 4 557 961 A (GORGES FRIEDRICH J) 10. Dezember 1985 (1985-12-10) * Zusammenfassung * * Spalte 2, Zeile 17 - Zeile 24 * * Abbildung 1 * | 1,3,4,9, 11 | |
| A | AVIONICS: "How about this ? Avionics would go in plane's skin" ELECTRONICS, 15. Oktober 1987 (1987-10-15), Seite 39 XP002145516 New York, USA * das ganze Dokument * | 5,7 | |
| Y | EP 0 147 627 A (URSPRUNG REINHARD) 10. Juli 1985 (1985-07-10) * Zusammenfassung * | 3 | |
| Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt | | | RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) |
| | | | B64C F24D B61C B64D H05B |
| Recherchenort | | Abschlußdatum der Recherche | |
| DEN HAAG | | 23. August 2000 | |
| | | Prüfer | |
| | | Estrela y Calpe, J | |
| KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE | | | |
| <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> | | | |
| <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p> | | | |

EPO FORM 1503/03 82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 6295

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

23-08-2000

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | | Datum der Veröffentlichung |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------|
| JP 07032518 | A | 03-02-1995 | KEINE | | |
| US 4557961 | A | 10-12-1985 | WO | 8404727 A | 06-12-1984 |
| | | | EP | 0144318 A | 19-06-1985 |
| EP 0147627 | A | 10-07-1985 | DE | 3342755 A | 05-06-1985 |

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)